

レーザー切断・穴あけ加工装置(LTS社製LDS D-3000M)

製造元	Laser Total Solution Ltd.
仕様	波長 355 nm, パルス幅: 40 ns
保有部署	材料化学専攻 無機構造化学分野
設置場所	桂・イノベーションプラザ棟・207室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/f6rs2o.pdf
注意事項等	
連絡先	材料化学専攻 無機構造化学分野 助教 清水雅弘 075-383-2463 shimizu.masahiro.3m (at) kyoto-u.ac.jp http://func.mc.kyoto-u.ac.jp/
キーワード	穴あけ、マーキング、表面処理
機器コード	(KUMaCo稼働開始後、追記します)
自由記入欄	紫外ナノ秒レーザーを用いた極薄板の穴あけやマーキングなどの表面処理が可能

